

COB加工生产 cob邦定加工 大浪街道加工

产品名称	COB加工生产 cob邦定加工 大浪街道加工
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

SMT规划书smt全套解决方案：

全自动化配线方案：SMT全自动上板机 全自动锡膏印刷机 接驳台 3D-SPI锡膏厚度检测仪器 贴片机 接驳台 在线AOI自动光学检测仪器 回流焊 SMT全自动缓存PCBA板机 在线AOI NG/OK全自动收板机

随着时代的发展，信息时代的到来，高新科技的引进。SMT贴片与DIP插件电子厂的改革，也在不断的更新当中。

现在让我们来说说SMT贴片与DIP插件电子厂都有哪些历史性的改革吧！

SMT贴片与DIP插件电子厂手工插件变全自动高速插件机。以前，我们都是用手工来插件，COB加工厂家，而现在用的是全自动高速插件机，其效果是从一个主控板要几十个人来插件改为一台进口插件机可以代替几十个人，并且合格率达99.99%。

SMT表面贴装设备特点：

表面贴装技术（SMT）是新一代电子组装技术，目前国内大部分电子产品均普遍采用SMT贴装工艺，随电子科技的发展，表面贴装工艺将是电子行业的必然趋势。

SMT表面贴装技术含概很多方面，诸如电子元件、集成电路的设计制造技术，电子产品的电路设计技术，自动贴装设备的设计制造技术，装配制造中使用的辅助材料的开发生产技术，电子产品防静电技术等，因此，一个完整、美观、系统测试性能良好的电子产品的产生会有诸多方面的因素影响。

那么，从检查方面来看，以前是人工检查主控板合不合格，而现在是自动化AOI在线测试仪自动检测，AOI自动光学检测仪是在PCB生产线上把SMD零件贴装以后，或者焊锡过后，PCBA外观自动光学检测仪，测出不良，另外，提供了在生产工程上的各种统计资料，可正确地了解不良的原因及内容，从而提高生产效率。

SMT贴片与DIP插件加工是目前最热门的电子组装技术，有些时候，生产线上出现效率或质量问题，其主要原因就在于我们没有从工艺的角度来分析和处理，而是把焦点放在了诸如设备和设计等其他问题上。SMT贴片与DIP插件加工是目前最热门的电子组装技术，有些时候，生产线上出现效率或质量问题，大浪街道加工，其主要原因就在于我们没有从工艺的角度来分析和处理，而是把焦点放在了诸如设备和设计等其他问题上。

DIP 封装

DIP 是直插式，属于 THT 插件类，二极管、电容电阻等基本都属于插件。SMT 是表面贴装技术，QFP、BGA 等都属于贴片。两者组线区别：THT:插件线（插件机）-上板机-波峰焊-下板机-皮带线 SMT：印刷机-接驳台-贴片机-接驳台-回流焊-工作台上个世纪的 70 年代，芯片封装基本都采用

DIP（Dual In-line Package，COB 加工设计，双列直插式封装）封装，此封装形式在当时具有适合 PCB（印刷电路板）穿孔安装，布线和操作较为方便等特点。DIP 封装的结构形式多种多样，包括多层陶瓷双列直插式 DIP，单层陶瓷双列直插式 DIP，引线框架式 DIP 等。但 DIP 封装形式封装效率是很低的，其芯片面积和封装面积之比为

1：1.86，这样封装产品的面积较大，内存条 PCB 板的面积是固定的，封装面积越大在内存上安装芯片的数量就越少，内存条容量也就越小。同时较大的封装面积对内存频率、传输速率、电器性能的提升都有影响。理想状态下芯片面积和封装面积之比为 1：1 将是至好的，但这是无法实现的，除非不进行封装，但随着封装技术的发展，这个比值日益接近，现在已经有了 1：1.14 的内存封装技术。DIP 封装（Dual In-line Package）

，也叫双列直插式封装技术，是一种最简单的封装方式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式，其引脚数一般不超过 100。DIP 封装的 CPU 芯片有两排引脚，需要插入到具有 DIP 结构的芯片插座上。当然，也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP 封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心，以免损坏管脚。DIP 封装结构形式有：多层陶瓷双列直插式 DIP，单层陶瓷双列直插式 DIP，引线框架式 DIP（含玻璃陶瓷封接式，塑料包封结构式，陶瓷低熔玻璃封装式）等。DIP 封装的特点 封装的特点：适合在 PCB（印刷电路板）上穿孔焊接，操作方便。芯片面积与封装面积之间的比值较大，故体积也较大。最早的 4004、8008、8086、8088 等 CPU 都采用了 DIP 封装，通过其上的两排引脚可插到主板上的插槽或焊接在主板上。

采用这种封装方式的芯片有两排引脚，COB 加工生产，可以直接焊在有 DIP 结构的芯片插座上或焊在有相同焊孔数的焊位中。其特点是可以很方便地实现 PCB 板的穿孔焊接，和主板有很好的兼容性。但 DIP 封装形式封装效率是很低的，其芯片面积和封装面积之比为 1：1.86，这样封装产品的面积较大，内存条 PCB 板的面积是固定的，封装面积越大在内存上安装芯片的数量就越少，内存条容量也就越小。同时较大的封装面积对内存频率、传输速率、电器性能的提升都有影响，而且引脚在插拔过程中很容易被损坏，可靠性较差。理想状态下芯片面积和封装面积之比为 1：1 将是至好的，但这是无法实现的，除非不进行封装，但随着封装技术的发展，这个比值日益接近，现在已经有了 1：1.14 的内存封装技术。但是由于其封装面积和厚度都比较大，同时这种封装方式由于受工艺的影响，引脚一般都不超过 100 个。随着 CPU 内部的高度集成化，DIP 封装很快退出了历史舞台。只有在老的 VGA/SVGA 显卡或 BIOS 芯片上可以看到它们的“足迹”。SOIC（Small Outline Integrated Circuit Package）

，小外形集成电路封装，指外引线数不超过 28 条的小外形集成电路，一般有宽体和窄体两种封装形式。其中具有翼形短引线者称为 SOL 器件，具有 J 型短引线者称为 SOJ 器件。SOIC 是表面贴装集成电路封装形式中的一种，它比同等的 DIP 封装减少约

30-50%的空间，厚度方面减少约70%。与对应的DIP封装有相同的插脚引线。对这类封装的命名约定是在SOIC或SO后面加引脚数。例如，14pin的4011的封装会被命名为SOIC-14或SO-14。

COB加工生产-cob邦定加工-大浪街道加工由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司(www.hyxinhe.com)在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒域新和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘秋梅。